证券代码：300054　　证券简称：鼎龙股份　　公告编号：2025-030

湖北鼎龙控股股份有限公司 2024年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	鼎龙股份	股票代码	300054
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨平彩	黄云	
办公地址	武汉市经济技术开发区东荆河路1号	武汉市经济技术开发区东荆河路1号	
传真	027-59720699	027-59720677	
电话	027-59720699	027-59720677	
电子信箱	ypc@dl-kg.com	huangyun@dl-kg.com	

2、报告期主要业务或产品简介

鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，目前重点聚焦半导体创新材料领域中；半导体制造用CMP工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，并持续在其他相关大应用领域的创新材料端进行拓展布局。此外，公司在传统打印复印通用耗材业务领域进行了全产业链布局。

图2.2.1：鼎龙业务布局情况

★ 业务概要

(1)半导体业务

①半导体制造用工艺材料

A.CMP制程工艺材料

CMP抛光材料是集成电路制造中至关重要的半导体材料，根据SEMI数据，CMP抛光材料在集成电路制造材料成本中占比7%，其中CMP抛光垫、CMP抛光液、CMP清洗液合计占CMP抛光材料成本的85%以上。随着半导体产业规模的增长和制程工艺的进步、芯片堆叠层数的增加，抛光步骤和CMP耗材用量将会增加，CMP材料市场将进一步扩大。

公司致力于为下游晶圆厂客户提供整套的一站式CMP核心材料及服务，持续提升系统化的CMP环节产品支持能力、技术服务能力、整体方案解决能力，努力成为国内首家也是唯一一家集成电路CMP环节全产品综合性方案提供商。目前，在CMP抛光垫产品方面，公司是国内唯一一家全面掌握CMP抛光垫全流程核心研发技术和生产工艺的CMP抛光垫供应商，确立CMP抛光垫国产供应龙头地位，产品深度渗透国内主流晶圆厂客户，成为部分客户的第一供应商，被多家晶圆厂核心客户评为优秀供应商；在CMP抛光液产品方面，公司全面开展全制程CMP抛光液产品布局，搭配自主研磨粒子在客户端持续推广、导入，逐步形成规模销售；在清洗液产品方面，公司铜制程CMP后清洗液持续稳定获得订单，其他制程抛光后清洗液产品结合整体业务战略安排进行开发验证，持续完善业务布局。

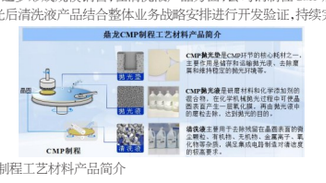


图2.2.2：鼎龙CMP制程工艺材料产品简介

B.高端晶圆光刻胶

晶圆光刻胶是半导体光刻工艺中的关键材料，目前国内在先进的KrF、ArF、EUV光刻胶领域尚未实现大规模量产，而KrF、ArF光刻胶因其覆盖了从0.25?m到7nm的主要半导体先进制造工艺，是现阶段迫切需要实现国产化技术突破的半导体关键材料，具有十分重要的战略意义和经济价值。据CEMIA统计，2022年中国集成电路晶圆制造用光刻胶市场规模为33.58亿元，其中KrF与ArF光刻胶合计占比超过66%；预计到2025年，中国集成电路晶圆制造用光刻胶市场规模将达到37.64亿元，其中KrF与ArF光刻胶市场规模将达到25.01亿元。

公司着力攻克高端KrF/ArF光刻胶自主化难关，实现“卡脖子”的高端光刻材料产业化，推动高端光刻胶的国产替代进程。基于公司对高端晶圆光刻胶原料自主合成的技术能力、进口替代类关键光刻胶产品成熟的开发经验、丰富的半导体材料产业化经验和对半导体行业的深厚理解和客户基础，公司开展了高端晶圆光刻胶领域的业务布局，产品开发、验证快速推进，产业化建设同步进行。

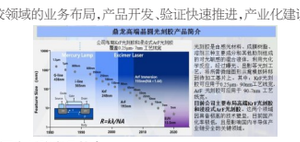


图2.2.3：鼎龙高端晶圆光刻胶产品简介

②半导体显示材料

公司围绕柔性OLED显示屏幕制造用的上游核心“卡脖子”材料布局，推出黄色聚酰亚胺浆料YPI、光敏聚酰亚胺浆料PSPI、薄膜封装材料TFE-INK等系列产品。目前，公司YPI、PSPI、TFE-INK产品已在客户端规模销售，并已成为国内部分主流面板客户YPI、PSPI产品的第一供应商，确立YPI、PSPI产品国产供应领先地位。同时，公司凭借在OLED显示材料领域多年的积累，对标国际一流共同探索未来显示技术工艺路线及相应材料应用方向，努力成为新型显示前沿技术的创新材料支持商。

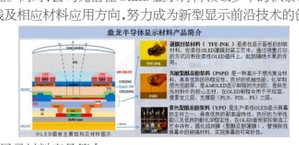


图2.2.4：鼎龙半导体显示材料产品简介

③半导体先进封装材料

先进封装是超越摩尔定律的关键赛道，同时在全球半导体产业博弈升级的背景下，先进封装有望成为国内半导体制程节点持续发展的突破口。目前国内先进封装技术处于发展阶段，上游先进封装材料环节较为薄弱，供应链自主化程度低，高端稀缺的关键封装材料基本被海外供应商垄断，国产替代空间广阔。

公司围绕半导体先进封装上游几款自主化程度低、技术难度高、未来增量空间较大的材料产品进行布局，目前重点开发半导体封装PI、临时键合胶等产品，快速推动先进封装材料项目的产品开发验证、市场推广，力争在“卡脖子”高端封装材料市场中开拓出新的市场空间。

图2.2.5：鼎龙半导体先进封装材料产品简介

④集成电路芯片设计和应用

集成电路芯片设计是集成电路产业链上游的重要环节。公司子公司旗捷科技是一家集研发、生产与销售为一体的具有专业集成电路设计与应用能力的企业，深耕打印复印耗材芯片细分领域17年，拥有自主独立知识产权产品，国内领先的公司自有芯片分析实验室，是国家高新技术企业，纳入国家发改委重点布局软件企业，是国家级专精特新小巨人企业。公司稳步完善芯片产品矩阵，同时针对芯片制造环节部分关键技术的“卡脖子”问题，积极在半导体设备配件领域进行布局和探索。

(2)打印复印通用耗材业务

公司是打印复印通用耗材龙头企业，以全产业链运营为发展思路，上游提供彩色聚合碳粉、显影辊等打印复印耗材核心原材料，下游销售硒鼓、墨盒两大终端耗材产品，实现产业上下游的联动，支持公司的竞争优势地位。目前，公司是全球激光打印复印通用耗材生产商中产品体系最全、技术跨度最大、以自主知识产权和专有技术为基础的市场导向型创新整合商。彩色碳粉领域，公司是国内唯一掌握四种颜色制备工艺，且规模最大、产品型号最齐全、技术最先进的兼容彩粉企业；再生墨盒领域，子公司绩迅科技是国家工信部再制造墨盒产品认定的首家企业，是国家级专精特新小巨人企业。

图2.2.6：鼎龙打印复印通用耗材产品简介

★ 经营情况与主要业绩驱动因素

鼎龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类创新材料的平台型公司，目前重点聚焦半导体创新材料领域中：半导体制造用CMP工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，并持续在其他相关大应用领域的创新材料端进行拓展布局。在材料创新平台的搭建过程中，公司一直是在与国际巨头的竞争中学习，在学习中竞争；创新也由开始的追赶创新，向平行创新，到未来引领创新的思路发展。同时，鼎龙也一直坚持“四个同步”：一是坚持材料技术创新与上游原材料自主化培养同步；二是坚持材料技术创新与用户验证工艺发展同步；三是坚持材料技术创新与人才团队培养同步；四是坚持材料技术的进步与知识产权建设同步，以此引领企业持续创新发展。

2024年度，公司实现营业收入33.38亿元，同比增长25.14%；实现归属于上市公司股东的净利润5.21亿元，同比增长134.54%。其中，今年第四季度：实现营业收入9.12亿元，同比增长14.76%；实现归属于上市公司股东的净利润1.44亿元，同比增长215.57%。经营业绩同比变动的原因主要系：

①半导体业务已成为驱动公司主营业务收入及净利润双增长的重要动力。公司CMP抛光材料、半导体显示材料产品已在国内主流晶圆厂、显示面板厂客户端模放量销售，市场渗透率持续提升，部分产品已取得国内龙头或销售领先的地位；报告期内半导体行业及新型OLED显示行业规模的增长，同样促进了公司半导体业务销售规模进一步提升。此外，公司前期孵化的半导体先进封装材料及高端晶圆光刻胶业务现均已取得销售收入，有利于上述新成长业务逐渐向减亏方向迈进。从而带动半导体业务及公司整体净利润规模的提升。

②降本控费专项工作带来盈利能力和运营效率的提升。公司结合业务实际、寻找降本点并持续跟进，在成本优化、效率提升，重点运营费用控制等方面都取得了阶段性的成果，管理效能提升，盈利能力增强。

③报告期内，因实施上市公司股权激励计划，计提股份支付费用4,417万元，从而影响公司归母净利润3,919万元。

④报告期内，高端晶圆光刻胶、半导体先进封装材料业务尚属于市场开拓及放量初期，尚未盈利，且新领域地方开发持续投入等，一定程度上影响了本报告期的归母净利润水平。

本报告期，公司经营性现金流量净额为8.28亿元，同比增长54.99%，现金流情况稳健，为公司各项业务的发展、投入提供了有力支持。公司维持较高研发投入力度，报告期内研发投入金额4.62亿元，较上年同期增长21.01%，占营业收入的比例为13.86%，为各类新产品及配套资源的快速布局提供了坚实的支撑，创新材料与技术的平台化布局持续完善，综合创新能力得到进一步巩固与提升。

本报告期，公司在行业内及资本市场获评多项荣誉：

①行业内所获荣誉：公司获得第五届中国电子材料行业50强、电子化工材料专业10强称号；旗下控股子公司—鼎汇微电子荣获国家专精特新重点“小巨人”企业称号，柔显科技成为旗下第4家入选国家专精特新“小巨人”企业的公司；鼎汇获得众国内主流晶圆厂客户的杰出供应商等合作奖项，柔显获得维信诺卓越贡献奖、天马优秀合作伙伴奖等；PSPI产品荣获2024年DIC国际显示材料创新金奖、中国电子材料行业协会卓越贡献奖等。上述荣誉展现了公司半导体创新材料平台型企业的综合实力、行业影响力及产品竞争力。

②资本市场端所获荣誉：公司荣获深交所信息披露A级评级，连续2年获得A级评价；先后入选中证500指数、中证A500指数，入选“创业板开市15周年15家创新成长先锋企业”、财联社“最具投资价值奖”、“2024年度湖北上市公司市值管理优秀实践案例”，上述荣誉彰显了监管机构和资本市场对公司在信息披露质量、规范运作水平、投资者关系管理等方面的高度认可与肯定。

本报告期，公司主要业务进展情况如下：

(1)半导体业务

2024年，公司半导体板块业务(含半导体材料业务及集成电路芯片设计和应用业务)实现主营业务收入15.2亿元(其中芯片业务收入已剔除内部抵消)，同比增长77.40%，占公司总营业收入比例持续提升。各细分业务具体进展如下：

①CMP抛光垫业务：2024年，累计实现产品销售收入7.16亿元，同比增长71.51%；其中，第四季度实现产品销售收入1.93亿元，同比增长28.77%。公司于2024年5月、9月分别首次实现抛光垫单月销量破2万片、3万片的历史新高，产品在国内市场的渗透程度随订单增长稳步加深，CMP抛光垫国产供应龙头地位持续巩固。

抛光硬垫方面，成熟制程客户稳定供应，交货量连创新高；产品技术节点提升，制程占比及客户范围持续扩大，相关新增产品取得批量订单。公司在本土外资晶圆厂客户取得突破，铜制程抛光硬垫产品已在某主流外资逻辑厂商测试通过并取得小批量订单，与更多本土外资及海外客户紧密接洽推广中，进一步提升了公司在全球CMP抛光垫领域强大的竞争力。产能建设方面，武汉本部抛光硬垫产线产能至2025年一季度末已提升至月产4万片左右(即年产约50万片)，为未来进一步放量销售做好产能储备。

抛光软垫方面，各类产品产销快速提升中，潜江工厂于8月份实现扭亏为盈，转入持续盈利模式。集成电路制程用软抛光垫进入稳定供应状态，产品良率持续提升；在硅晶圆及碳化硅市场进行积极探索，拓宽市场，成功取得国内主流的硅晶圆厂家订单，产品种类持续丰富，竞争力得到显著提升。

原材料方面，公司已全面实现CMP抛光硬垫核心原材料的自主制备，其中：预聚体持续稳定供应，缓冲垫在潜江稳定生产；微球已在客户端测试通过，在仙桃园区的产能建设至2025年一季度末已完成，并已开始试生产。公司抛光垫产品的综合竞争力得到进一步增强。

②CMP抛光液、清洗液业务：2024年，累计实现产品销售收入2.15亿元，同比增长178.89%；其中，第四季度实现产品销售收入7.502万元，同比增长159.61%。

CMP抛光液产品的核心原材料研磨粒子自主供应链优势凸显，搭载自产四大体系研磨粒子(超纯氧化硅溶胶、高纯氧化硅溶胶、氧化铝、氧化铈)的抛光液产品市场接受度持续提高。

介电层抛光液方面，为满足客户产能的扩增，仙桃园区抛光液及配套超纯硅研磨粒子产线通过下游晶圆厂客户审核，保质保量满足订单需求；同时扩展更多使用场景，在新客户端对已有产品进行迭代验证，进展顺利。

多晶硅、氮化硅抛光液在已有客户需求量不断提升的同时，配合新客户的工艺需求开发定制化产品，围绕研磨粒子和化学配方两方面的改进，推出具有市场竞争力的产品，在新客户验证通过。

金属栅极抛光液(铝栅极、钨栅极)应用自产氧化铝研磨粒子，在客户端稳定放量供应。下游客户在28nm及以下工艺节点的产能持续释放，新客户对金属栅极抛光液的需求不断提升，已在多家新客户研发线进行导入验证。为满足未来市场对该产品的需求量，自产氧化铝研磨粒子新增了连续出料工程化产线，不断优化工艺以稳定产品质量，保障未来增量市场供应。

搭载自主化氧化硅研磨粒子的铜及阻挡层抛光液在客户端验证持续推进，根据客户产线的多重需求，从研磨粒子与化学配方两个维度不断优化，持续深化技术定制服务。

氧化铈研磨粒子完成工程化产线建设，搭载其生产的浅沟槽隔离抛光液已送至客户端验证，反馈良好。

清洗液方面，铜CMP后清洗液产品在国内多家客户增量销售，其他制程清洗液取得一定销售收入，另有多款新产品在客户端持续技术验证中。

③半导体显示材料业务：2024年，累计实现产品销售收入4.02亿元，同比增长131.12%；其中，第四季度实现产品销售收入1.20亿元，同比增长74.81%。

公司YPI、PSPI产品的国产供应领先地位得到巩固，是国内部分主流面板厂客户的第一供应商，市场占有率随销售增长不断提升；TFE-INK产品市场份额也进一步提高，为订单规模持续增加打下良好基础。产能建设方面，仙桃产业园年产1,000吨PSPI产线投产并持续批量供应，产能布局及生产体系能力提升；YPI产品启动扩产计划，在仙桃实施年产800吨YPI二期项目建设，计划2025年内完工试运行，以缓解武汉本部YPI一期产能压力，满足未来持续增长的产品订单供应。

新产品方面，公司与国际一流厂商同步竞争，持续进行无氟光敏聚酰亚胺(PFAS Free PSPI)、黑色像素定义层材料(BPDL)、薄膜封装低介电材料(Low Dk INK)等新一代OLED显示材料的创新研发及送样验证，目标填补相关领域空白；目前，公司PFAS Free PSPI、BPDL产品各项指标性能处于国内领先、国际一流水平，已完成性能优化、实验线验证阶段，并送样国内主流面板厂客户G6代线验证。快速推进PI取向液的产品开发，在客户端的验证已全面展开。

报告期内，公司全面深入生产管理和控制，保障产品质量及稳定交付；创新产品分析方法，提效降本；持续推进供应链国产化工作，提升原材料供应安全性，优化采购成本。公司半导体显示材料业务综合竞争力进一步提升。

④高端晶圆光刻胶业务：2024年，公司浸没式ArF及KrF晶圆光刻胶产品首获国内主流晶圆厂客户订单，业务推进节奏迅速。产品开发方面，截至目前，公司已布局20余款高端晶圆光刻胶，已有12款送样客户端验证，其中7款进入加仑样阶段，整体测试进展顺利。产能建设方面，公司潜江一期年产30吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶产线具备批量化生产及供货能力，能够满足客户端现阶段的订单需求；二期年产300吨KrF/ArF高端晶圆光刻胶量产线建设在按计划顺利推进中，主体设备基本到位，进入设备安装阶段。供应链管理方面，公司开发出KrF、ArF光刻胶专用树脂及其高纯度单体、光致产酸剂等关键材料，同时在国内寻求有实力的合作伙伴，实现从关键材料到光刻胶产品自主可控的全流程国产化，符合下游客户产业链供应链安全自主可控的需求。体系建设方面，公司已搭建全链条、全过程、全员参与的三位一体的预防性质量管理体系，建立先进的光刻胶检测分析实验室和应用评价实验室，保障产品质量的一致性和可靠性。

⑤半导体先进封装材料业务：2024年，公司首次获得半导体封装PI、临时键合胶产品的采购订单，合计销售收入544万元。半导体封装PI方面，公司已布局7款产品，全面覆盖非光敏PI、正性PSPI和负性PSPI，并已送样6款，验证进展顺利，客户反馈良好，其中1款于2024年上半年取得首张批量订单，形成业务突破；临时键合胶方面，公司完成了在国内某主流集成电路制造客户端的量产导入，于2024年下半年首获订单，在持续规模出货中。目前，这两类产品的产线建设、应用评价体系和品管体系建设均已完成，具备量产供货能力，能够满足客户端持续订单需求；供应链自主化持续进行，实现其上游核心原材料的国产供应或自制替代。

⑥集成电路芯片设计和应用：报告期内，公司持续发布多款打印耗材芯片新品，进一步完善芯片产品矩阵，优化芯片设计、提升分析能力，进一步增强公司芯片业务的核心竞争力；新业务领域新品按计划开发、测试中。此外，针对芯片制造环节部分关键技术的“卡脖子”问题，积极在半导体设备零部件领域进行布局和探索，公司在该业务方向上，已完成前期市场调研及国内主流晶圆厂商的技术研发合作探讨，并取得重要技术突破，已获得正式订单并实现少量营业收入。

(2)打印复印通用耗材业务

公司打印复印通用耗材业务稳健运营，2024年实现销售收入17.9亿元(不含打印耗材芯片)，较上年同期持平。报告期内，打印复印通用耗材各细分领域均取得进展：彩色碳粉中的打印粉年销售量首次突破2,000吨；硒鼓业务销售收入同比增长、全自动化产线的实际产量持续增加；墨盒业务销售收入、净利润均同比提升，经营规模进一步突破。

此外，公司在成本挖潜、提升运营效率方面持续发力，抓实各项降本增效工作，结合各细分业务特点进行产品降本、物料降本、运费管控、人效提升等多项优化，包括：专项优化采购供方选择和比价、多渠道供应资源优化管理；优化客户及产品结构，持续产品降本方案，降低模具及生产辅助耗材成本，提高产品合格率；集中排产、出货管理，整合空运点加大海运，优化库存及物流成本管理；优化人工配置、充分发挥自动化生产效率，提升人均产出及效率等。通过多举措提升整体盈利能力，打印复印通用耗材业务的综合竞争力持续增强。

(3)管理效能提升

公司通过信息赋能、AI赋能、创新赋能，持续提升公司的综合竞争力，助力公司高质量发展。

①信息赋能：公司持续推进武汉、潜江、仙桃等园区的信息化建设，实现了三地两数据中心的信息互联互通，对生产经营过程中关键数据进行记录与分析，建立数据池协助进行业务分析和精细管理；通过智慧系统进行安全、消防统一管控，有效降低消防安全隐患、提升园区安全管理效率；增强信息安全建设，适应高科技创新型企业保密管理需要。

②AI赋能：公司使用先进AI工具提升公司运行效率，探索AI技术在公司研发、生产、市场经营中的应用。如在研发端，使用AI技术辅助进行材料配方和实验条件设计优化、分子合成路线设计、数据分析建模等过程，着力提升研发效率；在生产端，使用AI技术协助生产调度和能耗优化、设备预测性维护、工艺参数优化等，实现生产效能提升。

③创新赋能：创新是企业发展的持续动力，公司结合整体业务发展战略持续进行人才团队培养和人员结构优化，不断增强公司技术人员与客户端实际应用工艺的沟通密度，持续进行创新材料与技术的平台化布局，进一步提升公司创新效率及创新成果转化率。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	7,394,760,416.32	6,707,901,850.45	10.24%	5,621,937,946.08
归属于上市公司股东的净资产	4,502,976,558.73	4,468,459,439.70	0.77%	4,214,810,310.29
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	3,337,642,949.46	2,667,127,862.20	25.14%	2,721,483,697.38
归属于上市公司股东的净利润	520,696,454.43	222,007,881.42	134.54%	390,066,787.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	468,805,021.14	164,342,123.52	185.26%	348,091,624.86
经营活动产生的现金流量净额	828,202,089.61	534,348,648.61	54.99%	562,786,027.33
基本每股收益(元/股)	0.56	0.24	133.33%	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.55	0.24	129.17%	0.41
加权平均净资产收益率	10.63%	4.94%	5.69%	8.97%

(2)分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	707,994,878.10	810,825,697.07	906,918,128.11	911,904,246.18
归属于上市公司股东的净利润	81,575,829.89	136,264,622.98	158,482,197.99	144,373,803.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,847,768.53	130,825,962.73	146,704,786.75	125,426,503.13
经营活动产生的现金流量净额	166,078,223.90	174,737,638.90	267,774,944.98	219,611,281.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,199	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	42,927	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
朱双全	境内自然人	14.84%	139,249,514	104,437,135	质押	2,400,000
朱熙全	境内自然人	14.71%	138,031,414	103,523,560	质押	7,660,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.38%	41,140,475	0	---	---
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	2.01%	18,837,591	0	---	---
上海理成资产管理有限公司—理成圣远1号A期私募投资基金	境内非国有法人	1.40%	13,162,127	0	---	---
招商银行股份有限公司—兴全全球视野智选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.39%	13,059,163	0	---	---
中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红-个人分红	境内非国有法人	1.22%	11,426,986	0	---	---
招商银行股份有限公司—兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.13%	10,559,909	0		---
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	10,540,850	0	---	---
上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有序1号私募证券投资基金	境内非国有法人	1.03%	9,660,956	0	---	---
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱双全与朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。除上述情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	9,471,272	1.01%	807,100	0.09%	18,837,591	2.01%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

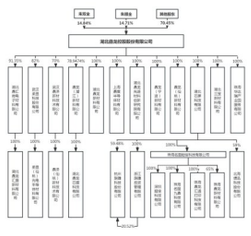
公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

具体参见2024年年度报告全文。

湖北鼎龙控股股份有限公司

法定代表人：朱双全

2025年4月29日

证券代码：002212　　证券简称：天融信　　公告编号：2025-017

天融信科技集团股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	335,664,964.65	421,972,881.83	-20.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-68,388,818.56	-89,313,612.79	23.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-75,799,036.95	-94,838,431.22	20.08%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-230,087,379.16	-165,889,719.61	-38.70%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.08	25.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	-0.73%	-0.95%	0.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,746,400,716.55	11,046,222,054.93	-2.71%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,325,030,090.28	9,393,418,908.84	-0.73%

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	45,829.73	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,267,328.18	不包含软件产品增值税退税在内的其他政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,681,966.91	合营企业借权利息收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	192,619.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-144,524.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,656,303.59	主要为收到北京火绒网络科技有限公司分红200万元、个税手续费返还65.63万元
减：所得税影响额	1,289,304.84	
合计	7,410,218.39	---

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

☑适用 □不适用

主要为收到北京火绒网络科技有限公司分红200万元、个税手续费返还65.63万元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☑适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
软件产品增值税退税	20,703,102.62	增值税即征即退收入

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

公司继续推进提质增效战略，报告期归属于上市公司股东的净利润为-6,838.88万元，同比减亏23.43%，毛利率上升10.15个百分点，三项费用同比减少6.83%。

1、受宏观经济增速放缓等多种因素影响，网络安全行业短期需求继续承压，加之上年度，年底传统旺季成色不足，结转订单减少，使报告期营业收入受到影响。

2、公司发挥自身竞争优势，优化市场竞争策略，加强项目筛选与取舍，收入质量在上年度好转的基础上继续得到较大幅度的提升，毛利率同比增长10.15个百分点。

3、公司持续加强管理，强化费用管控，报告期三项费用同比减少6.83%。

公司于2025年2月11日发布的智算一体机，在报告期已实现销售收入。报告期内，公司持续深化人工智能技术布局，构建“AI+安全”融合创新体系与推进智算云业务，技术研发与产业应用取得显著突破：

1、天问大模型技术实现跨越式升级：完成天问大模型与DeepSeek-R1智能基座深度对接，产品小天上7个安全智能体全面集成DeepSeek能力，并赋能网络安全产品。通过本地化部署，进一步提升了安全知识产出效率和产品竞争力。

2、智算基础设施布局取得里程碑进展：公司发布智算云平台和智算一体机，拓展了公司在云计算领域的产品与业务覆盖，加速向智算云领域推进，提升了盈利空间。目前智算一体机已实现销售，形成软硬一体化的行业解决方案交付能力。

3、推出全景式大模型防护方案：深度融合大模型对抗训练技术与传统安全防护体系，构建包含数据泄露防护、提示词攻击拦截、输出内容过滤的三重防护机制。提升了公司网络安全产品的应用场景，并增强了方案竞争力。

4、公司全面构建AI驱动的数字化转型体系：强化AI在公司内部应用与赋能，涉及产品开发、知识生产、安全服务、运营支撑等，公司经营进一步提质增效。

单位：元

报表项目	2025年3月31日	2024年12月31日	同比变动金额	同比变动比例	变动原因
货币资金	352,505,573.05	665,617,022.91	-313,111,449.86	-47.04%	主要系公司销售存在季节性，资金回流主要集中在第四季度，年末资金结余较高，第一季度资金回收相对较少，支出较多。
应收票据	3,427,664.05	11,425,264.53	-7,997,600.48	-70.00%	主要系公司持有的应收票据在报告期内陆续到期，公司收回现金所致。
合同资产	107,392,451.73	75,973,657.50	31,418,794.23	41.35%	主要系公司完成部分履约义务并已确认收入的安全服务未收到回款所致。
其他流动资产	27,484,987.26	20,674,625.11	6,810,362.15	32.94%	主要系待抵扣及待认证进项税额增加所致。
开发支出	284,441,615.22	215,611,982.79	68,829,632.43	31.92%	主要系报告期资本化投入增加所致。
递延所得税资产	188,895,930.78	113,027,172.02	75,868,758.76	67.12%	主要系报告期可抵扣亏损增加所致。
应付票据	32,312,250.00	47,246,725.00	-14,934,475.00	-31.61%	主要系报告期以银行承兑汇票形式支付的货款减少所致。
预收款项